

## SMT-Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend, 1-/2-reihig SMT Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row

### Technische Daten / Technical Data

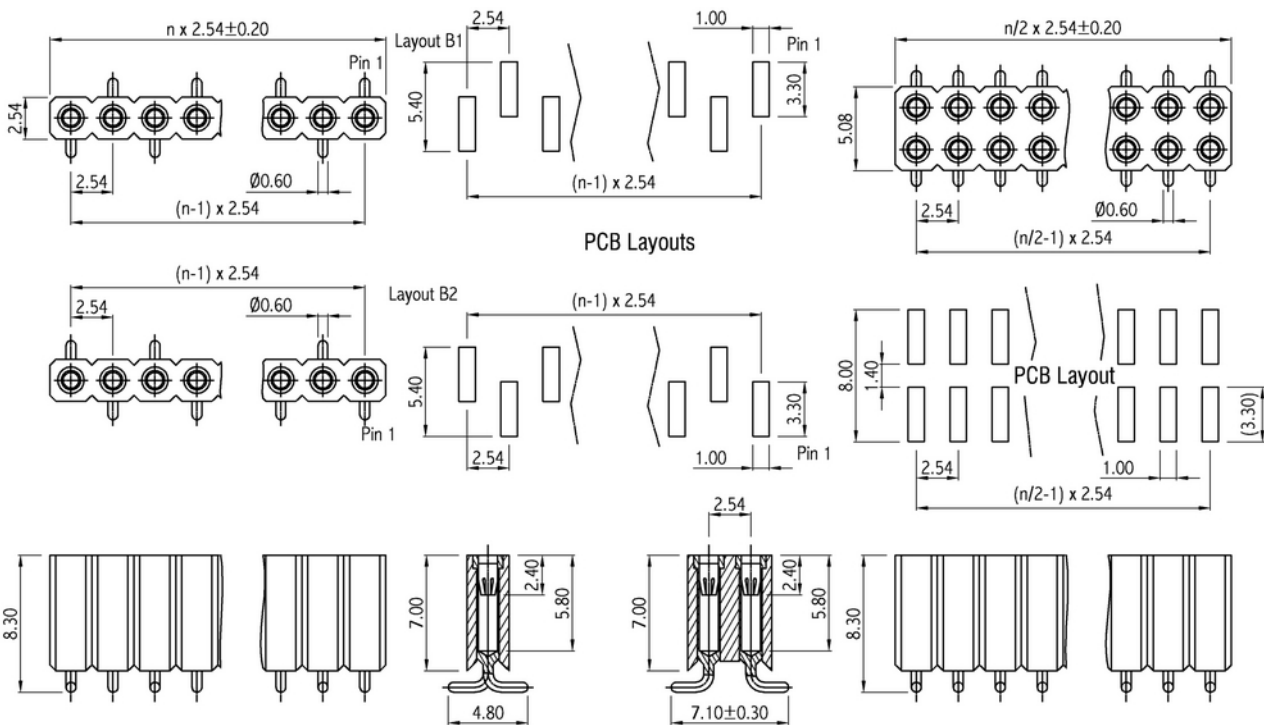
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>RMS</sub>
Test Voltage	1kV <sub>RMS</sub>
Nennspannung	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Voltage Rating	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.

Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins. Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Series	Contacts*	Rows*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Packaging*
<b>1531</b>	<b>036</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>00</b>	<b>ST</b>
	003-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row	1 Einreihig B1 Single row B1 2 Einreihig B2 Single row B2 3 Zweireihig Double row	50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	00 Feder vergoldet Gold plated clip 10 Feder 0,25µm Gold 0.25µm gold plated clip 30 Feder 0,75µm Gold 0.75µm gold plated clip	ST PPST PPTR

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
 FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
 WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

